

# 글로벌 No.1 소재 · 부품 기업



# History



1970-1998

## 창업·기반구축

- 1970 / 회사 설립
- 1971 / 국내 최초 TV 튜너 생산
- 1984 / 반도체 마스크 생산
- 1990 / 포토 마스크 생산
- 1997 / 반도체 기판 생산



1999-2008

## 성장·발전

- 2000 / LED, 테이프 서브스트레이트 사업 전개
- 2001 / 파워모듈 사업 전개
- 2002 / 디지털 튜너 글로벌 M/S 1위
- 2003 / 카메라 모듈 사업 전개
- 2007 / 차량부품 사업 전개



2009-2021

## 시장 선도

- 2009 / 테이프 서브스트레이트 글로벌 M/S 1위
- 2011 / 카메라모듈 글로벌 M/S 1위
- 2012 / 포토마스크 글로벌 M/S 1위
- 2013 / 세계 최초 6인치 웨이퍼 UV LED 양산
- 2014 / 차량용 통신모듈 글로벌 M/S 1위
- 2016 / 듀얼 카메라 글로벌 시장 선점
- 2017 / 세계 최초 100mW UV-C LED 개발
  - 세계 최초 글라스렌즈 적용 듀얼 카메라모듈 개발
  - 세계 최초 2세대 V2X 풀모듈 개발
- 2018 / 어드밴스트 플립칩 LED 패키지 개발
  - 차량용 'C-V2X 모듈' 개발
- 2019 / 3D 센싱부품 'ToF 모듈' 본격 양산
  - 차량용 플렉시블 입체조명 '넥슬라이드-HD' 개발
  - 세계 최초 5G 퀄컴칩기반 '차량용 통신모듈' 개발
- 2020 / 세계 최소형 IoT용 'BLE모듈' 개발
  - 고효율 자성소재 개발
- 2021 / 차량용 '디지털 키 모듈' 개발
  - 세계 최초 '차량용 와이파이6E 모듈' 개발

# Vision



# Global Network

## KOREA

1 본사

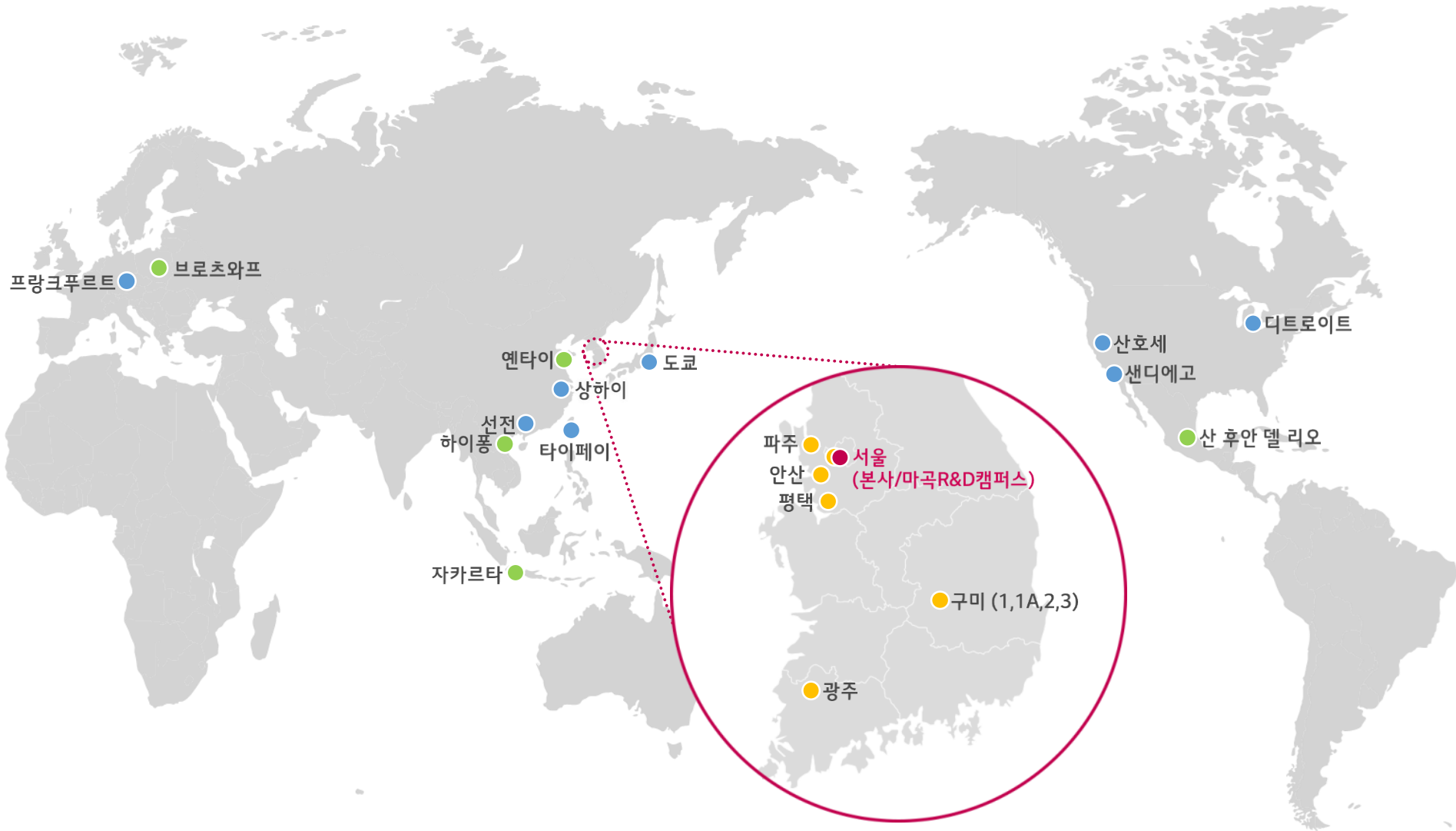
6 사업장

## Overseas

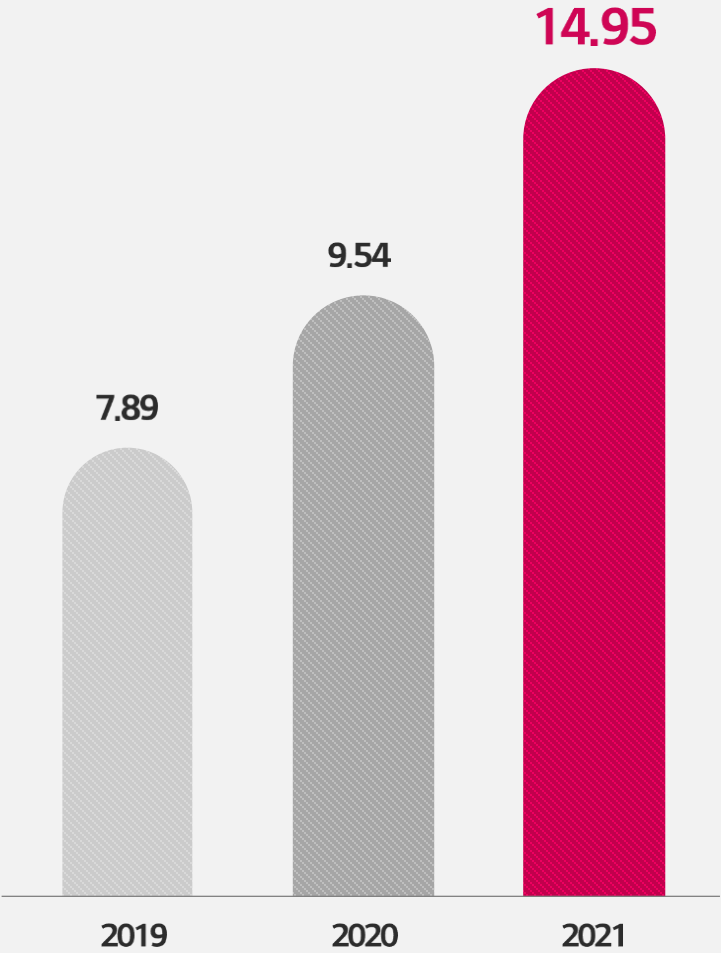
5 생산법인

8 판매법인/지사/사무소

- 본 사
- 사업장
- 생산법인
- 판매법인 / 지사 / 사무소

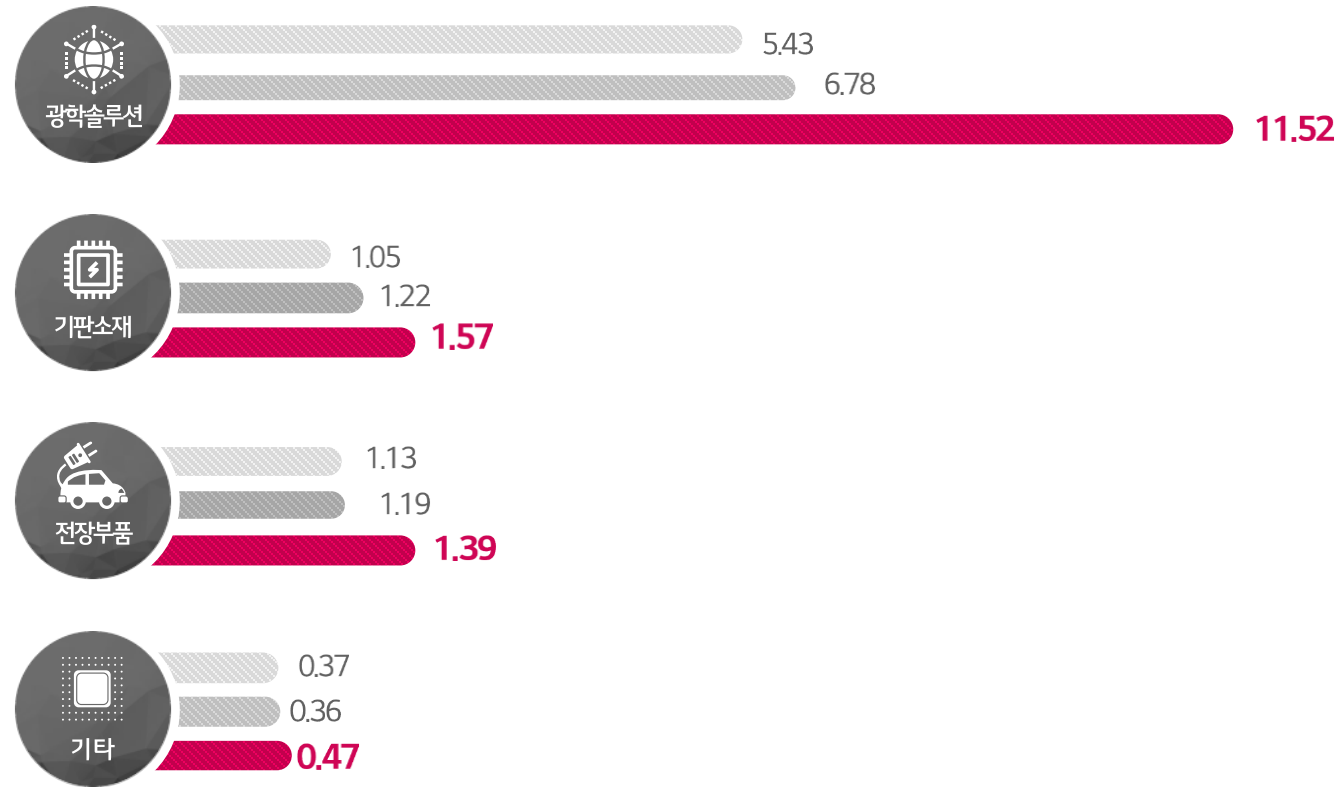


# Business Performance

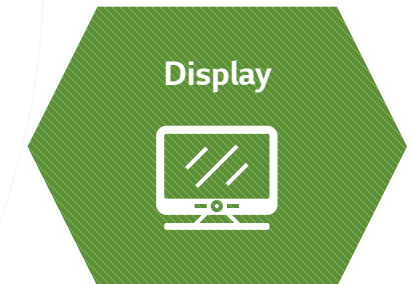
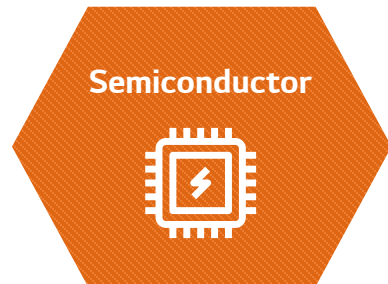
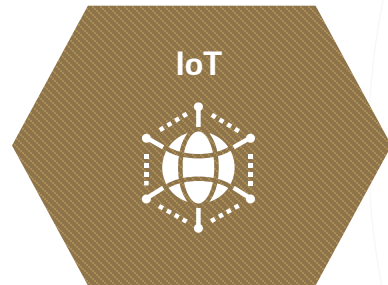


## 사업부별 매출 실적

○ 2019 ○ 2020 ● 2021 (단위:조원)



# Business Area



# Mobile Components



Mobile



3D Sensing Module



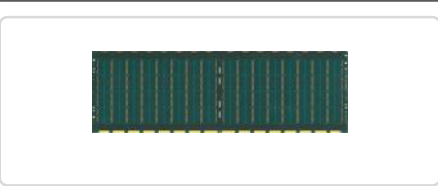
Camera Module



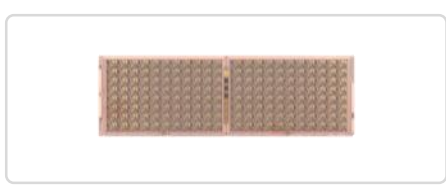
Flip Chip CSP (ETS-TCFC)



CSP (Ultra Thin)



SiP



COF



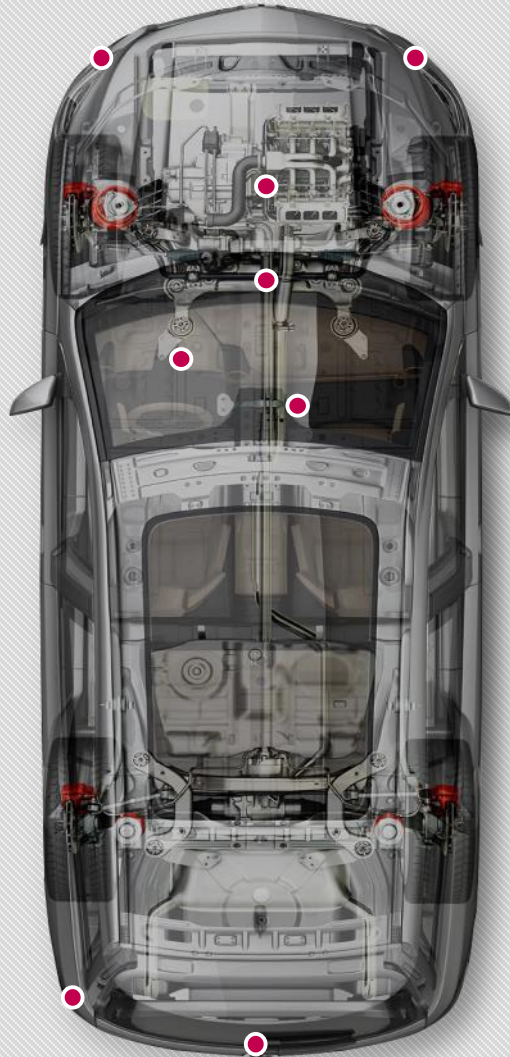
2 Metal COF



# Automotive Components



Automotive



## Actuator & Sensor Solution

- ❑ Motor for Electric power steering (EPS)
- ❑ Motor for Braking system (ABS/ESC/AEB)
- ❑ Gear Integrated Module for FBS
- ❑ Motor for Dual clutch transmission (DCT)
- ❑ Electric Oil Pump
- ❑ Sensor for Steering system (TAS/TOS/TIS)



## Connectivity & Camera Solution

- ❑ Cellular Module (LTE/5G)
- ❑ Bluetooth / Wi-Fi module
- ❑ V2X module
- ❑ Radar
- ❑ Camera module



## xEV Solution

- ❑ Battery Management System
- ❑ DC-DC Converter
- ❑ Electric Vehicle Communication Controller



## Lighting Solution

- ❑ LED Module for Automotive
- ❑ LED Driver Module for Automotive



# IoT Components



IoT



## Wi-Fi Module



## BLE SiP



## Smart Camera for IoT



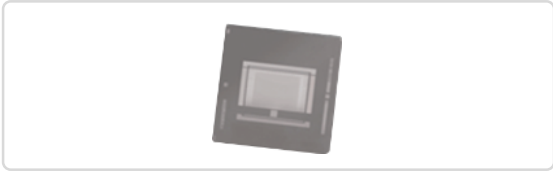
# Display Components



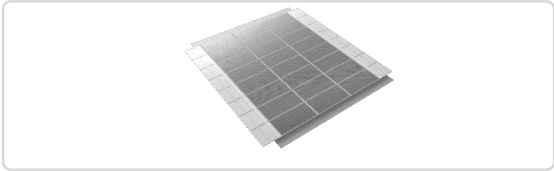
Display



Photo Mask



OLED Mask



Power Module



Digital Tuner



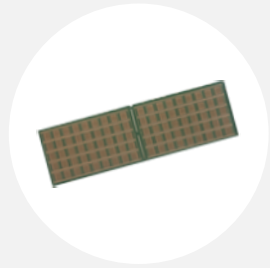
# Semiconductor Components



Semiconductor

## Flip Chip CSP (ETS-TCFC)

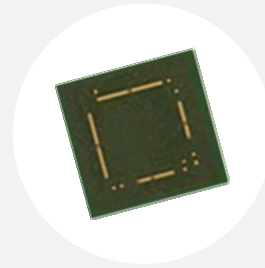
- ❑ Mobile phone
- ❑ Portable device



01

## CSP (Ultra Thin)

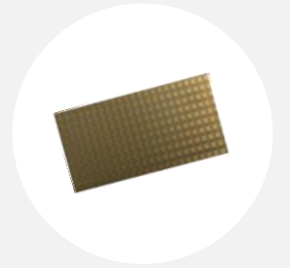
- ❑ Mobile phone
- ❑ Portable device



02

## SiP

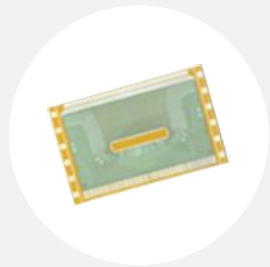
- ❑ Mobile phone
- ❑ Portable device



03

## COF

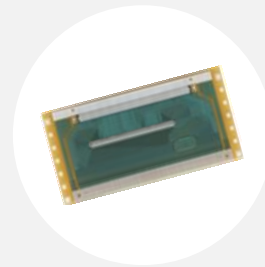
- ❑ Mobile phone
- ❑ Portable device
- ❑ Display



04

## 2 Metal COF

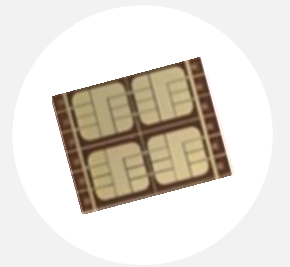
- ❑ Mobile phone
- ❑ Portable device



05

## COB (Smart IC)

- ❑ Banking/Credit card
- ❑ USIM card
- ❑ ID card
- ❑ Transportation card



06

## 완벽 품질



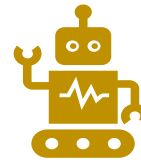
글로벌 품질표준

ISO 9001  
IATF16949  
ISO 26262



품질 혁신

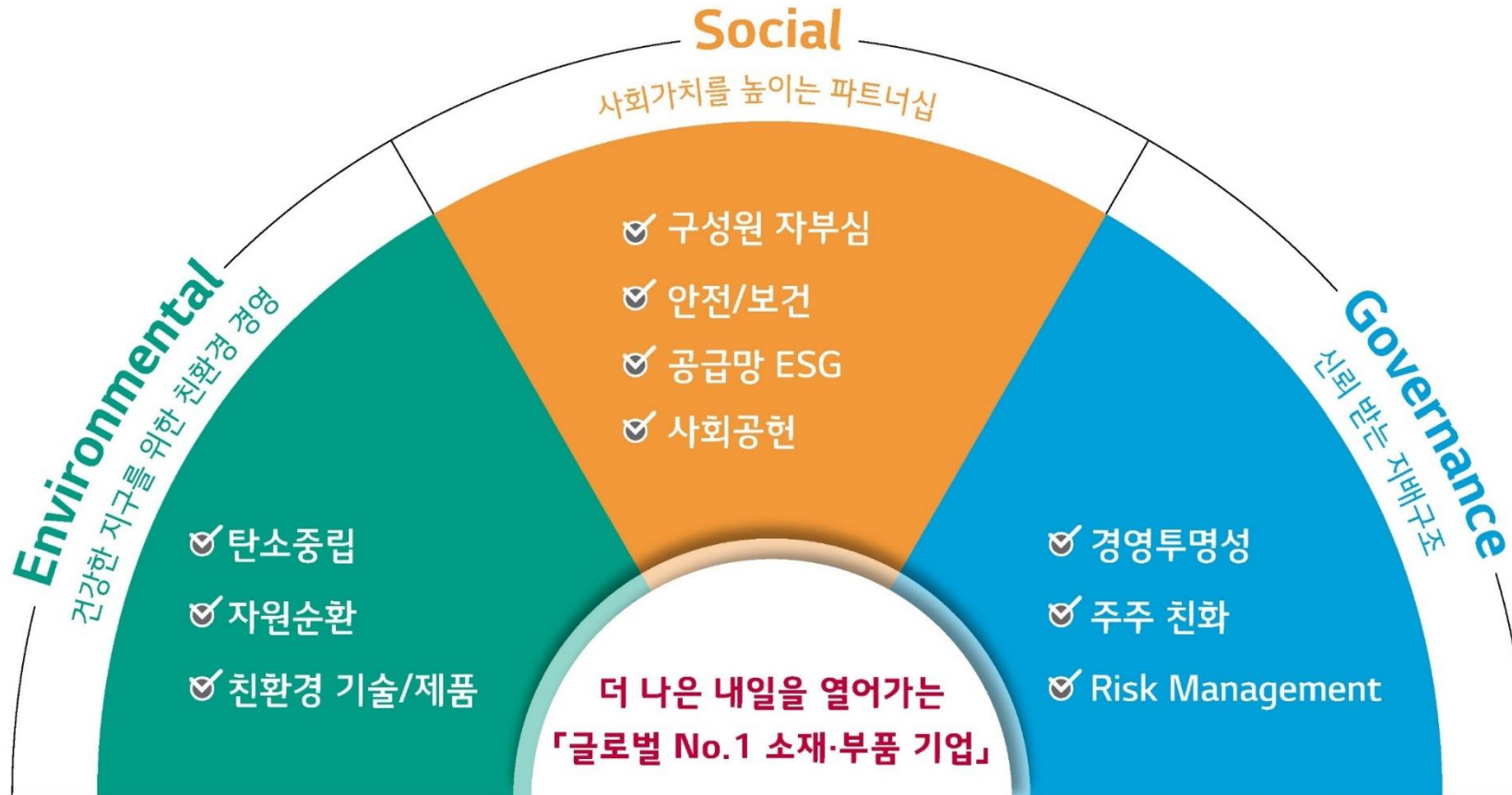
고객가치 제공을 위한  
품질 혁신



품질 관리

선행 품질관리 시스템  
Big Data / AI 기반 품질관리

# ESG Vision/Management



## Vision

더 나은 내일을 열어가는  
「글로벌 No.1 소재부품 기업」

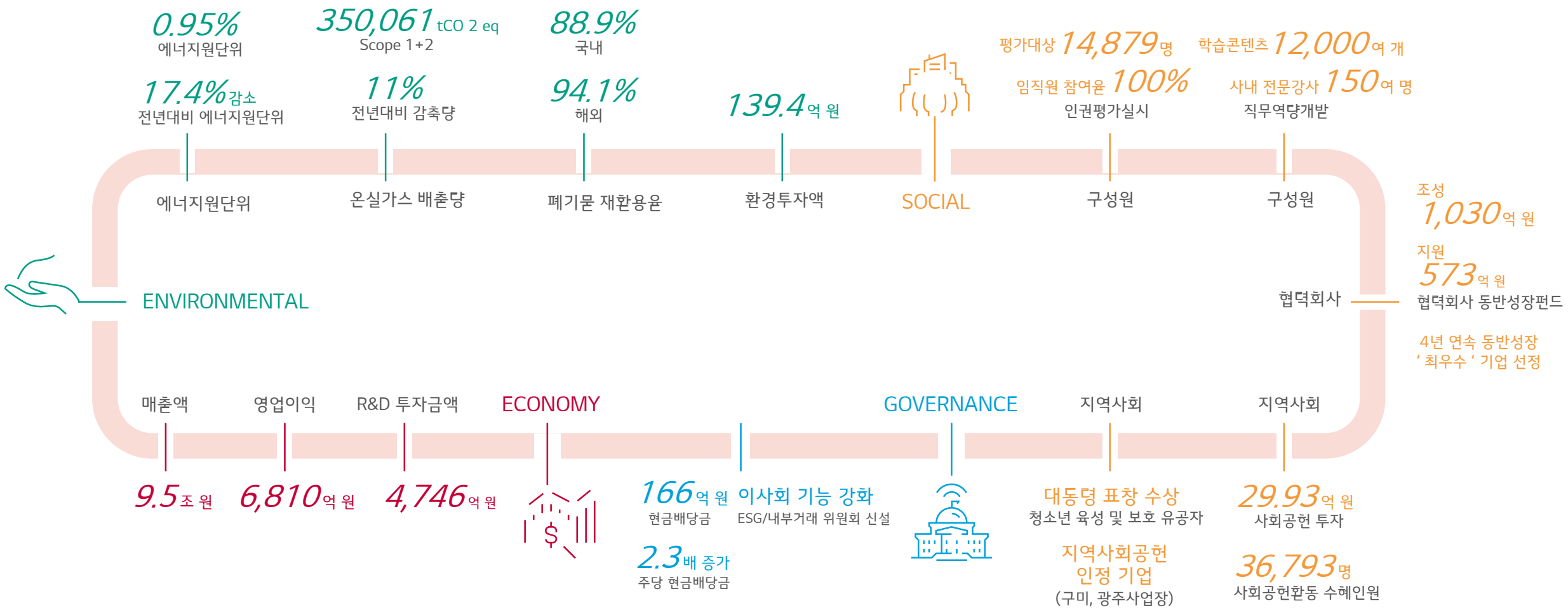
## 전략방향

[E] 건강한 지구를 위한 친환경 경영  
[S] 사회가치를 높이는 파트너십  
[G] 신뢰받는 지배구조

## 중점 추진과제

탄소중립, 구성원 자부심 등 10대 과제

# 2020 ESG Highlights





# Customer Value Creation

고객 맞춤형 가치 제공 + 장기적 파트너십 구축



## 기본가치

QCD를 통한  
고객 신뢰 확보



## 경쟁가치

차별화된  
경쟁우위 제공



## 미래가치

선(先)제안을 통한  
미래사업 실현